

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2025-060

芯联集成电路制造股份有限公司

2025年度第一期短期融资券（科创债）发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 1 日召开第二届董事会第六次会议，于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请注册发行总额不超过人民币 40 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。其中，中期票据不超过人民币 25 亿元，超短期融资券不超过人民币 15 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在指定媒体披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于拟申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2025-036）。

公司已于近日完成了芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券（债券简称：25 芯联集成 SCP001(科创债)）的发行。本期债券发行额为 5 亿元人民币，期限为 270 天，债券面值为人民币 100 元，发行利率为 1.6%。

本期债券由浙商银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于公司经营发展，调整优化公司债务结构，降低财务费用，支持公司的高质量发展。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日